

Title (en)

Bath for the galvanic deposition of a coating of a gold-indium alloy.

Title (de)

Bad zur galvanischen Abscheidung von Gold-Indium-Legierungsüberzügen.

Title (fr)

Bain de dépôt galvanique d'un revêtement d'un alliage d'or-indium.

Publication

**EP 0198998 A1 19861029 (DE)**

Application

**EP 86100721 A 19860121**

Priority

DE 3505473 A 19850216

Abstract (en)

[origin: US4617096A] Light yellow, glossy and ductile gold-indium alloys which have a good resistance to gradual corrosion by silver sulfide are obtained from electrolytic (galvanic) baths containing 1 to 20 g/l of gold in the form of alkali or ammonium tetracyanoaurate (III), 0.5-50 g/l of indium in the form of a water soluble indium salt, a buffer or conducting salt and 0.5 to 10 mg/l of selenium and/or tellurium.

Abstract (de)

Hellgelbe, glänzende und duktile Gold-Indium-Legierungsüberzüge, die eine gute Beständigkeit gegenüber Kriechkorrosion durch Silbersulfid aufweisen, erhält man aus galvanischen Bädern, die neben 1 bis 20 g/l Gold in Form von Alkalitetracyanoaurat (III), 0,5-50 g/l Indium in Form eines wasserlöslichen Indiumsalzes, einer Säure und einem Puffer- bzw. Leitsalz noch 0,5 bis 10 mg/l Selen und/oder Tellur enthalten.

IPC 1-7

**C25D 3/62**

IPC 8 full level

**C25D 3/62** (2006.01)

CPC (source: EP US)

**C25D 3/62** (2013.01 - EP US)

Citation (search report)

- [YD] EP 0037535 A2 19811014 - DEGUSSA [DE]
- [Y] EP 0119424 A1 19840926 - DEGUSSA [DE]
- [Y] FR 2538816 A1 19840706 - OMI INT CORP [US]
- [A] CH 418085 A 19660731 - PILOT PEN CO LTD [JP]

Cited by

US4916235A; US7465385B2; US8142637B2

Designated contracting state (EPC)

BE CH DE FR GB IT LI

DOCDB simple family (publication)

**DE 3505473 C1 19860605**; BR 8600414 A 19861014; DE 3660353 D1 19880804; EP 0198998 A1 19861029; EP 0198998 B1 19880629; HK 58091 A 19910802; JP S61190089 A 19860823; US 4617096 A 19861014; ZA 86305 B 19860827

DOCDB simple family (application)

**DE 3505473 A 19850216**; BR 8600414 A 19860203; DE 3660353 T 19860121; EP 86100721 A 19860121; HK 58091 A 19910725; JP 2807886 A 19860213; US 82329386 A 19860128; ZA 86305 A 19860115